

Product Change Notice (PCN)

件名: 弊社 SRAM : TSOP 製品の後工程組立工場追加

発行日: 7/27/2022

出荷開始予定日: 1/10/2023

改版履歴:

Rev.1.0 : 新規発行

変更内容の説明:

弊社 SRAM : TSOP 製品の後工程組立工場につきまして、従来の Amkor Technology Malaysia Sdn. Bhd. (以下、ATM)での生産に対して、Greatek Electronics Inc.(以下、GTK)を追加いたします。

GTK 品の組立材料は、GTK の標準材料を使用します。ATM 品と GTK 品の比較概要につきましては、2 ページをご参照ください。

また、型名毎の比較詳細につきましては、別紙(CST-R2-AJ151 補足資料)をご参照ください。

対象製品リスト:

R1LP5256ESA-5SI#B1	R1LP5256ESA-5SI#S1	R1LV5256ESA-5SI#B1	R1LV5256ESA-5SI#S1
R1LP0108ESA-5SI#B1	R1LP0108ESA-5SI#S1	R1LV0108ESA-5SI#B1	R1LV0108ESA-5SI#BJ
R1LV0108ESA-5SI#S1	R1LV0208BSA-5SI#B1	R1LV0208BSA-5SI#BK	R1LV0208BSA-5SI#S1
R1LV0208BSA-5SI#SK	RMLV0408EGSA-4S2#AA1	RMLV0408EGSA-4S2#KA1	R1LV0216BSB-5SI#B1
R1LV0216BSB-5SI#S1	R1RP0416DSB-0PI#D1	R1RP0416DSB-2LR#D1	R1RP0416DSB-2LR#S1
R1RP0416DSB-2PI#D1	R1RP0416DSB-2PR#D1	R1RP0416DSB-2PR#S1	R1RP0416DSB-2SR#D1
R1RW0416DSB-0PI#D1	R1RW0416DSB-0PI#S1	R1RW0416DSB-0PR#D1	R1RW0416DSB-0PR#S1
R1RW0416DSB-2LR#D1	R1RW0416DSB-2PI#D1	R1RW0416DSB-2PI#S1	R1RW0416DSB-2PR#D1
R1RW0416DSB-2PR#S1	R1RW0416DSB-2SR#D1	R1RW0416DSB-2UR#D1	RMLV0414EGSB-4S2#AA1
RMLV0414EGSB-4S2#HA1	RMLV0416EGSB-4S2#AA1	RMLV0416EGSB-4S2#HA1	RMLV0808BGSB-4S2#AA0
RMLV0808BGSB-4S2#HA0	RMLV0816BGSB-4S2#AA0	RMLV0816BGSB-4S2#HA0	RMLV0816BGSA-4S2#AA0
RMLV0816BGSA-4S2#KA0	RMLV1616AGSA-5S2#AA0	RMLV1616AGSA-5S2#KA0	RMLV3216AGSA-5S2#AA0
RMLV3216AGSA-5S2#KA0			

変更の理由:

組立工程の生産能力増強のため。

外形、実装、機能、品質、信頼性への影響:

影響なし。

製品の識別方法:

パッケージ表面のマーキングの原産国表示により、現行組立拠点品(ATM 品)との識別が可能です。詳細は別紙をご参照ください。

信頼性データについて: 9/12/2022 より順次ご提供可能

サンプル出荷予定日: 8/22/2022

製品/材料の化学物質データ: 9/12/2022 より順次ご提供可能

現行組立拠点品(ATM品)と追加組立拠点品(GTK品)の比較概要

項目	現行組立拠点品 (ATM品)	追加組立拠点品 (GTK品)	
組立拠点	Amkor Technology Malaysia Sdn. Bhd. (マレーシア)	Greatek Electronics Inc. (台湾)	
マーキング原産国表示	MALAYSIA	TAIWAN	
アセンブリ材料	リードフレーム材質	Cu	Cu
	インナーリード形状	現行形状 (ATM 独自仕様)	ATM品とは形状異なる (GTK 独自仕様)
	アウターリード形状	現行形状	ATM品と互換性あり
	リードめっき材	純 Sn	純 Sn
	ダイボンディング材	樹脂ペースト	樹脂ペースト
	ボンディングワイヤー材	Au	Au
	封止材料	エポキシ樹脂 (ハロゲンフリー)	エポキシ樹脂 (ハロゲンフリー)
チップ厚	280µm	254µm	
選別テスト拠点	Powertech Technology Inc. (台湾)	←	
梱包仕様	現行仕様	←	
防湿梱包性能	MSL 3	←	
出荷梱包ラベル	現行仕様	フォーマットの変更なし (内部コード、原産国は変更)	

現行組立拠点品(ATM品)と追加組立拠点品(GTK品)において、リードフレームのインナーリード形状とチップ厚は異なりますが、製品の電気的特性(DC/AC)は同等です。

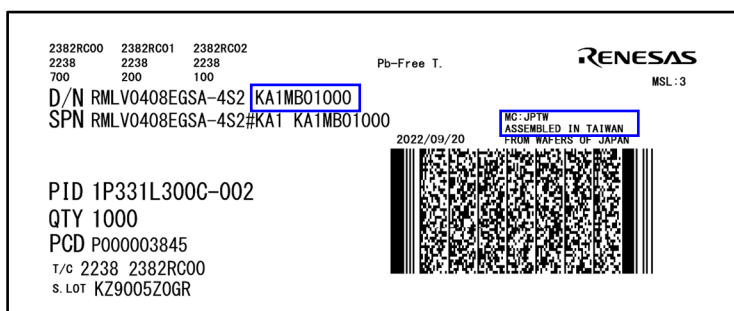
出荷ラベル仕様

- ラベルフォーマット自体の変更はございません。
- 追加組立拠点品(GTK品)は、「内部コード」と「原産国表示」の記載内容が変更になります。下記のラベル例をご参照ください。

現行組立拠点品 (ATM品)



追加組立拠点品 (GTK品)



ご注意:

1. PCN をお客様にお渡しした後 30 日以内に受理の御連絡を頂けない場合は、変更内容を御承認頂いたものとみなして変更を実施させていただきます。
2. お客様が PCN を受理されて承認手続きのための条件が有る場合は、PCN をお客様にお渡しした後 90 日以内に御連絡をお願い致します。90 日以内に何の御連絡もない場合も御承認頂いたものとみなして変更を実施させていただきます。
3. 変更内容について御承認頂けない場合、最終注文数の御提示と御発注をお願い致します。

この通知に関するお問い合わせは、弊社営業、特約店までお願い致します。

別紙：CST-R2-AJ151 補足資料

本別紙は、CST-R2-AJ151「弊社SRAM：TSOP製品の後工程組立工場追加」の補足資料として、変更前後での比較について記載しております。誠に恐縮ではございますが、主旨ご理解の上、追加製品の早期ご承認を賜ります様、ご協力の程よろしくお願い申し上げます。

なお、本資料において、現行組立拠点の「Amkor Technology Malaysia Sdn. Bhd.」は、ATMと略し、追加組立拠点の「Greatek Electronics Inc.」は、GTKと略します。

目次

1. 対象型名リスト	pp.2-3
2. 変更前後の比較	pp.4-19
3. 改訂記録	p.20

1. 対象型名リスト(1)

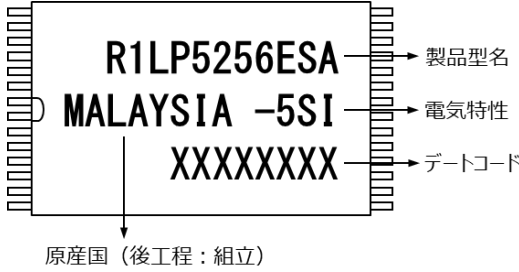
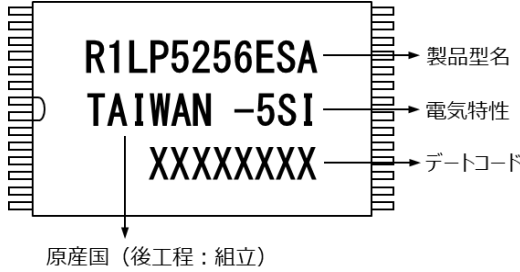
パッケージ タイプ	メモリ容量, 電源電圧	語 構成	発注型名		梱包仕様	変更前後 比較表の 参照ページ
			現行組立拠点品 (ATM品)	追加組立拠点品 (GTK品)		
28pin- TSOP(I)	256Kb 5V	x8	R1LP5256ESA-5SI#B1	←	トレイ	p.4
			R1LP5256ESA-5SI#S1	←	テープ&リール	
	256Kb 3V	x8	R1LV5256ESA-5SI#B1	←	トレイ	p.5
			R1LV5256ESA-5SI#S1	←	テープ&リール	
32pin- sTSOP(I)	1Mb 5V	x8	R1LP0108ESA-5SI#B1	←	トレイ	p.6
			R1LP0108ESA-5SI#S1	←	テープ&リール	
	1Mb 3V	x8	R1LV0108ESA-5SI#B1	←	トレイ	p.7
			R1LV0108ESA-5SI#BJ	←	トレイ	
			R1LV0108ESA-5SI#S1	←	テープ&リール	
	2Mb 3V	x8	R1LV0208BSA-5SI#B1	←	トレイ	p.8
			R1LV0208BSA-5SI#BK	←	トレイ	
			R1LV0208BSA-5SI#S1	←	テープ&リール	
			R1LV0208BSA-5SI#SK	←	テープ&リール	
	4Mb 3V	x8	RMLV0408EGSA-4S2#AA1	←	トレイ	p.9
			RMLV0408EGSA-4S2#KA1	←	テープ&リール	
	44pin- TSOP(II)	2Mb 3V	x16	R1LV0216BSB-5SI#B1	←	トレイ
R1LV0216BSB-5SI#S1				←	テープ&リール	
4Mb Fast 5V		x16	R1RP0416DSB-0PI#D1	←	トレイ	p.11
			R1RP0416DSB-2LR#D1	←	トレイ	
			R1RP0416DSB-2LR#S1	←	テープ&リール	
			R1RP0416DSB-2PI#D1	←	トレイ	
			R1RP0416DSB-2PR#D1	←	トレイ	
			R1RP0416DSB-2PR#S1	←	テープ&リール	
			R1RP0416DSB-2SR#D1	←	トレイ	
4Mb Fast 3.3V		x16	R1RW0416DSB-0PI#D1	←	トレイ	p.12
			R1RW0416DSB-0PI#S1	←	テープ&リール	
			R1RW0416DSB-0PR#D1	←	トレイ	
			R1RW0416DSB-0PR#S1	←	テープ&リール	
			R1RW0416DSB-2LR#D1	←	トレイ	
			R1RW0416DSB-2PI#D1	←	トレイ	
			R1RW0416DSB-2PI#S1	←	テープ&リール	
	R1RW0416DSB-2PR#D1		←	トレイ		
	R1RW0416DSB-2PR#S1		←	テープ&リール		
	R1RW0416DSB-2SR#D1		←	トレイ		
	R1RW0416DSB-2UR#D1		←	トレイ		

1. 対象型名リスト(2)

パッケージ タイプ	メモリ容量, 電源電圧	語 構成	発注型名		梱包仕様	変更前後 比較表の 参照ページ
			現行組立拠点品 (ATM品)	追加組立拠点品 (GTK品)		
44pin- TSOP(II)	4Mb 3V CS 1pin type	x16	RMLV0414EGSB-4S2#AA1	←	トレイ	p.13
			RMLV0414EGSB-4S2#HA1	←	テープ&リール	
	4Mb 3V CS 2pin type	x16	RMLV0416EGSB-4S2#AA1	←	トレイ	p.14
			RMLV0416EGSB-4S2#HA1	←	テープ&リール	
	8Mb 3V	x8	RMLV0808BGSB-4S2#AA0	←	トレイ	p.15
			RMLV0808BGSB-4S2#HA0	←	テープ&リール	
	8Mb 3V	x16	RMLV0816BGSB-4S2#AA0	←	トレイ	p.16
			RMLV0816BGSB-4S2#HA0	←	テープ&リール	
48pin- TSOP(I)	8Mb 3V	x16	RMLV0816BGSA-4S2#AA0	←	トレイ	p.17
			RMLV0816BGSA-4S2#KA0	←	テープ&リール	
	16Mb 3V	x16	RMLV1616AGSA-5S2#AA0	←	トレイ	p.18
			RMLV1616AGSA-5S2#KA0	←	テープ&リール	
	32Mb 3V	x16	RMLV3216AGSA-5S2#AA0	←	トレイ	p.19
			RMLV3216AGSA-5S2#KA0	←	テープ&リール	

2. 変更前後の比較

(1) 28pin-TSOP(I) 256Kb(5V) 製品型名：R1LP5256ESA-5SI

項目		現行組立拠点品 (ATM品)	追加組立拠点品 (GTK品)
発注型名		R1LP5256ESA-5SI#B1 (トレイ品)	←
		R1LP5256ESA-5SI#S1 (Tape & Reel品)	←
組立拠点		Amkor Technology Malaysia Sdn. Bhd. (マレーシア)	Greatek Electronics Inc. (台湾)
マーキング原産国表示		MALAYSIA	TAIWAN
JEITA Package Code		P-TSOP(1)28-8x11.8-0.55	←
パッケージ表面仕様			
アセンブリ材料	リードフレーム材質	Cu	Cu
	インナーリード形状	現行形状 (ATM独自仕様)	ATM品とは形状異なる (GTK独自仕様)
	アウターリード形状	現行形状	ATM品と互換性あり
	リードめっき材	純Sn	純Sn
	ダイボンディング材	樹脂ペースト	樹脂ペースト
	ボンディングワイヤー材	Au	Au
	封止材料	エポキシ樹脂 (ハロゲンフリー)	エポキシ樹脂 (ハロゲンフリー)
チップ厚	280μm	254μm	
選別テスト拠点		Powertech Technology Inc. (台湾)	←
梱包仕様		現行仕様	←
防湿梱包性能		MSL 3	←
出荷梱包ラベル		現行仕様	フォーマットの変更なし (内部コード、原産国は変更)

(2) 28pin-TSOP(I) 256Kb(3V) 製品型名 : R1LV5256ESA-5SI

項目	現行組立拠点品 (ATM品)	追加組立拠点品 (GTK品)	
発注型名	R1LV5256ESA-5SI#B1 (トレイ品)	←	
	R1LV5256ESA-5SI#S1 (Tape & Reel品)	←	
組立拠点	Amkor Technology Malaysia Sdn. Bhd. (マレーシア)	Greatek Electronics Inc. (台湾)	
マーキング原産国表示	MALAYSIA	TAIWAN	
JEITA Package Code	P-TSOP(1)28-8x11.8-0.55	←	
パッケージ表面仕様			
アセンブリ材料	リードフレーム材質	Cu	Cu
	インナーリード形状	現行形状 (ATM独自仕様)	ATM品とは形状異なる (GTK独自仕様)
	アウターリード形状	現行形状	ATM品と互換性あり
	リードめっき材	純Sn	純Sn
	ダイボンディング材	樹脂ペースト	樹脂ペースト
	ボンディングワイヤー材	Au	Au
	封止材料	エポキシ樹脂 (ハロゲンフリー)	エポキシ樹脂 (ハロゲンフリー)
チップ厚	280μm	254μm	
選別テスト拠点	Powertech Technology Inc. (台湾)	←	
梱包仕様	現行仕様	←	
防湿梱包性能	MSL 3	←	
出荷梱包ラベル	現行仕様	フォーマットの変更なし (内部コード、原産国は変更)	

(3) 32pin-sTSOP(I) 1Mb(5V) 製品型名 : R1LP0108ESA-5SI

項目		現行組立拠点品 (ATM品)	追加組立拠点品 (GTK品)
発注型名		R1LP0108ESA-5SI#B1 (トレイ品)	←
		R1LP0108ESA-5SI#S1 (Tape & Reel品)	←
組立拠点		Amkor Technology Malaysia Sdn. Bhd. (マレーシア)	Greatek Electronics Inc. (台湾)
マーキング原産国表示		MALAYSIA	TAIWAN
JEITA Package Code		P-TSOP(1)32-8x11.8-0.50	←
パッケージ表面仕様			
アセンブリ材料	リードフレーム材質	Cu	Cu
	インナーリード形状	現行形状 (ATM独自仕様)	ATM品とは形状異なる (GTK独自仕様)
	アウターリード形状	現行形状	ATM品と互換性あり
	リードめっき材	純Sn	純Sn
	ダイボンディング材	樹脂ペースト	樹脂ペースト
	ボンディングワイヤー材	Au	Au
	封止材料	エポキシ樹脂 (ハロゲンフリー)	エポキシ樹脂 (ハロゲンフリー)
チップ厚		280μm	254μm
選別テスト拠点		Powertech Technology Inc. (台湾)	←
梱包仕様		現行仕様	←
防湿梱包性能		MSL 3	←
出荷梱包ラベル		現行仕様	フォーマットの変更なし (内部コード、原産国は変更)

(4) 32pin-sTSOP(I) 1Mb(3V) 製品型名： R1LV0108ESA-5SI

項目		現行組立拠点品 (ATM品)	追加組立拠点品 (GTK品)
発注型名		R1LV0108ESA-5SI#B1/#BJ (トレイ品)	←
		R1LV0108ESA-5SI#S1 (Tape & Reel品)	←
組立拠点		Amkor Technology Malaysia Sdn. Bhd. (マレーシア)	Greatek Electronics Inc. (台湾)
マーキング原産国表示		MALAYSIA	TAIWAN
JEITA Package Code		P-TSOP(1)32-8x11.8-0.50	←
パッケージ表面仕様			
アセンブリ材料	リードフレーム材質	Cu	Cu
	インナーリード形状	現行形状 (ATM独自仕様)	ATM品とは形状異なる (GTK独自仕様)
	アウターリード形状	現行形状	ATM品と互換性あり
	リードめっき材	純Sn	純Sn
	ダイボンディング材	樹脂ペースト	樹脂ペースト
	ボンディングワイヤー材	Au	Au
	封止材料	エポキシ樹脂 (ハロゲンフリー)	エポキシ樹脂 (ハロゲンフリー)
チップ厚		280μm	254μm
選別テスト拠点		Powertech Technology Inc. (台湾)	←
梱包仕様		現行仕様	←
防湿梱包性能		MSL 3	←
出荷梱包ラベル		現行仕様	フォーマットの変更なし (内部コード、原産国は変更)

(5) 32pin-sTSOP(I) 2Mb(3V) 製品型名： R1LV0208BSA-5SI

項目	現行組立拠点品 (ATM品)	追加組立拠点品 (GTK品)	
発注型名	R1LV0208BSA-5SI#B1/#BK (トレイ品)	←	
	R1LV0208BSA-5SI#S1/#SK (Tape & Reel品)	←	
組立拠点	Amkor Technology Malaysia Sdn. Bhd. (マレーシア)	Greatek Electronics Inc. (台湾)	
マーキング原産国表示	MALAYSIA	TAIWAN	
JEITA Package Code	P-TSOP(1)32-8x11.8-0.50	←	
パッケージ表面仕様			
アセンブリ材料	リードフレーム材質	Cu	Cu
	インナーリード形状	現行形状 (ATM独自仕様)	ATM品とは形状異なる (GTK独自仕様)
	アウターリード形状	現行形状	ATM品と互換性あり
	リードめっき材	純Sn	純Sn
	ダイボンディング材	樹脂ペースト	樹脂ペースト
	ボンディングワイヤー材	Au	Au
	封止材料	エポキシ樹脂 (ハロゲンフリー)	エポキシ樹脂 (ハロゲンフリー)
チップ厚	280μm	254μm	
選別テスト拠点	Powertech Technology Inc. (台湾)	←	
梱包仕様	現行仕様	←	
防湿梱包性能	MSL 3	←	
出荷梱包ラベル	現行仕様	フォーマットの変更なし (内部コード、原産国は変更)	

(6) 32pin-sTSOP(I) 4Mb(3V) 製品型名：RMLV0408EGSA-4S2

項目		現行組立拠点品 (ATM品)	追加組立拠点品 (GTK品)
発注型名		RMLV0408EGSA-4S2#AA1 (トレイ品)	←
		RMLV0408EGSA-4S2#KA1 (Tape & Reel品)	←
組立拠点		Amkor Technology Malaysia Sdn. Bhd. (マレーシア)	Greatek Electronics Inc. (台湾)
マーキング原産国表示		MALAYSIA	TAIWAN
JEITA Package Code		P-TSOP(1)32-8x11.8-0.50	←
パッケージ表面仕様			
アセンブリ材料	リードフレーム材質	Cu	Cu
	インナーリード形状	現行形状 (ATM独自仕様)	ATM品とは形状異なる (GTK独自仕様)
	アウターリード形状	現行形状	ATM品と互換性あり
	リードめっき材	純Sn	純Sn
	ダイボンディング材	樹脂ペースト	樹脂ペースト
	ボンディングワイヤー材	Au	Au
	封止材料	エポキシ樹脂 (ハロゲンフリー)	エポキシ樹脂 (ハロゲンフリー)
チップ厚		280μm	254μm
選別テスト拠点		Powertech Technology Inc. (台湾)	←
梱包仕様		現行仕様	←
防湿梱包性能		MSL 3	←
出荷梱包ラベル		現行仕様	フォーマットの変更なし (内部コード、原産国は変更)

(7) 44pin-TSOP(II) 2Mb(3V) 製品型名 : R1LV0216BSB-5SI

項目		現行組立拠点品 (ATM品)	追加組立拠点品 (GTK品)
発注型名		R1LV0216BSB-5SI#B1 (トレイ品)	←
		R1LV0216BSB-5SI#S1 (Tape & Reel品)	←
組立拠点		Amkor Technology Malaysia Sdn. Bhd. (マレーシア)	Greatek Electronics Inc. (台湾)
マーキング原産国表示		MALAYSIA	TAIWAN
JEITA Package Code		P-TSOP(2)44-10.16x18.41-0.80	←
パッケージ表面仕様		<p>製品型名 電気特性 デートコード インデックスマーク 原産国 (後工程:組立)</p>	<p>製品型名 電気特性 デートコード インデックスマーク 原産国 (後工程:組立)</p>
アセンブリ材料	リードフレーム材質	Cu	Cu
	インナーリード形状	現行形状 (ATM独自仕様)	ATM品とは形状異なる (GTK独自仕様)
	アウターリード形状	現行形状	ATM品と互換性あり
	リードめっき材	純Sn	純Sn
	ダイボンディング材	樹脂ペースト	樹脂ペースト
	ボンディングワイヤー材	Au	Au
	封止材料	エポキシ樹脂 (ハロゲンフリー)	エポキシ樹脂 (ハロゲンフリー)
チップ厚		280μm	254μm
選別テスト拠点		Powertech Technology Inc. (台湾)	←
梱包仕様		現行仕様	←
防湿梱包性能		MSL 3	←
出荷梱包ラベル		現行仕様	フォーマットの変更なし (内部コード、原産国は変更)

(8) 44pin-TSOP(II) 4Mb Fast 5V 製品型名 : R1RP0416DSB-***

項目	現行組立拠点品 (ATM品)	追加組立拠点品 (GTK品)	
発注型名	R1RP0416DSB -0PI/2LR/2PI/2PR/2SR#D1 (トレイ品)	←	
	R1RP0416DSB-2LR/2PR#S1 (Tape & Reel品)	←	
組立拠点	Amkor Technology Malaysia Sdn. Bhd. (マレーシア)	Greatek Electronics Inc. (台湾)	
マーキング原産国表示	MALAYSIA	TAIWAN	
JEITA Package Code	P-TSOP(2)44-10.16x18.41-0.80	←	
パッケージ表面仕様 (図は一例)			
アセンブリ 材料	リードフレーム材質	Cu	Cu
	インナーリード形状	現行形状 (ATM独自仕様)	ATM品とは形状異なる (GTK独自仕様)
	アウターリード形状	現行形状	ATM品と互換性あり
	リードめっき材	純Sn	純Sn
	ダイボンディング材	樹脂ペースト	樹脂ペースト
	ボンディングワイヤー材	Au	Au
	封止材料	エポキシ樹脂 (ハロゲンフリー)	エポキシ樹脂 (ハロゲンフリー)
チップ厚	280μm	254μm	
選別テスト拠点	Powertech Technology Inc. (台湾)	←	
梱包仕様	現行仕様	←	
防湿梱包性能	MSL 3	←	
出荷梱包ラベル	現行仕様	フォーマットの変更なし (内部コード、原産国は変更)	

(9) 44pin-TSOP(II) 4Mb Fast 3.3V 製品型名 : R1RW0416DSB-***

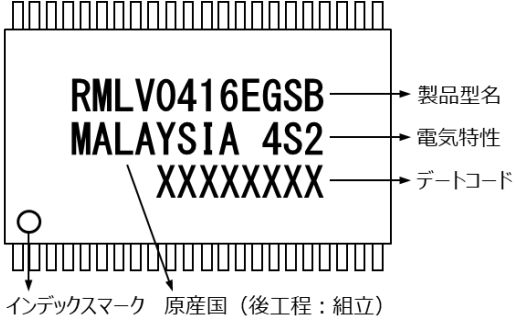
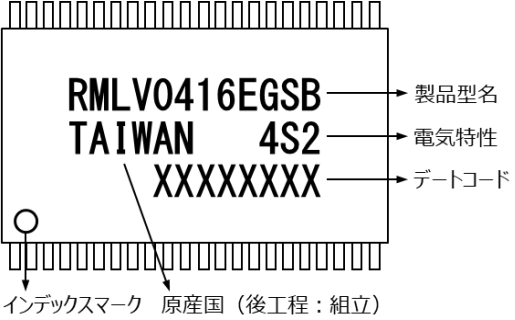
項目	現行組立拠点品 (ATM品)	追加組立拠点品 (GTK品)	
発注型名	R1RW0416DSB -0PI/0PR/2LR/2PI/2PR/2SR/2UR#D1 (トレイ品)	←	
	R1RW0416DSB -0PI/0PR/2PI/2PR#S1 (Tape & Reel品)	←	
組立拠点	Amkor Technology Malaysia Sdn. Bhd. (マレーシア)	Greatek Electronics Inc. (台湾)	
マーキング原産国表示	MALAYSIA	TAIWAN	
JEITA Package Code	P-TSOP(2)44-10.16x18.41-0.80	←	
パッケージ表面仕様 (図は一例)			
アセンブリ 材料	リードフレーム材質	Cu	Cu
	インナーリード形状	現行形状 (ATM独自仕様)	ATM品とは形状異なる (GTK独自仕様)
	アウターリード形状	現行形状	ATM品と互換性あり
	リードめっき材	純Sn	純Sn
	ダイボンディング材	樹脂ペースト	樹脂ペースト
	ボンディングワイヤー材	Au	Au
	封止材料	エポキシ樹脂 (ハロゲンフリー)	エポキシ樹脂 (ハロゲンフリー)
チップ厚	280μm	254μm	
選別テスト拠点	Powertech Technology Inc. (台湾)	←	
梱包仕様	現行仕様	←	
防湿梱包性能	MSL 3	←	
出荷梱包ラベル	現行仕様	フォーマットの変更なし (内部コード、原産国は変更)	

(10) 44pin-TSOP(II) 4Mb(3V) CS 1pin type

製品型名 : RMLV0414EGSB-4S2

項目		現行組立拠点品 (ATM品)	追加組立拠点品 (GTK品)
発注型名		RMLV0414EGSB-4S2#AA1 (トレイ品)	←
		RMLV0414EGSB-4S2#HA1 (Tape & Reel品)	←
組立拠点		Amkor Technology Malaysia Sdn. Bhd. (マレーシア)	Greatek Electronics Inc. (台湾)
マーキング原産国表示		MALAYSIA	TAIWAN
JEITA Package Code		P-TSOP(2)44-10.16x18.41-0.80	←
パッケージ表面仕様		<p>製品型名 電気特性 デートコード インデックスマーク 原産国 (後工程:組立)</p>	<p>製品型名 電気特性 デートコード インデックスマーク 原産国 (後工程:組立)</p>
アセンブリ材料	リードフレーム材質	Cu	Cu
	インナーリード形状	現行形状 (ATM独自仕様)	ATM品とは形状異なる (GTK独自仕様)
	アウターリード形状	現行形状	ATM品と互換性あり
	リードめっき材	純Sn	純Sn
	ダイボンディング材	樹脂ペースト	樹脂ペースト
	ボンディングワイヤー材	Au	Au
	封止材料	エポキシ樹脂 (ハロゲンフリー)	エポキシ樹脂 (ハロゲンフリー)
チップ厚		280μm	254μm
選別テスト拠点		Powertech Technology Inc. (台湾)	←
梱包仕様		現行仕様	←
防湿梱包性能		MSL 3	←
出荷梱包ラベル		現行仕様	フォーマットの変更なし (内部コード、原産国は変更)

(11) 44pin-TSOP(II) 4Mb(3V) CS 2pin type 製品型名 : RMLV0416EGSB-4S2

項目		現行組立拠点品 (ATM品)	追加組立拠点品 (GTK品)
発注型名		RMLV0416EGSB-4S2#AA1 (トレイ品)	←
		RMLV0416EGSB-4S2#HA1 (Tape & Reel品)	←
組立拠点		Amkor Technology Malaysia Sdn. Bhd. (マレーシア)	Greatek Electronics Inc. (台湾)
マーキング原産国表示		MALAYSIA	TAIWAN
JEITA Package Code		P-TSOP(2)44-10.16x18.41-0.80	←
パッケージ表面仕様			
アセンブリ材料	リードフレーム材質	Cu	Cu
	インナーリード形状	現行形状 (ATM独自仕様)	ATM品とは形状異なる (GTK独自仕様)
	アウターリード形状	現行形状	ATM品と互換性あり
	リードめっき材	純Sn	純Sn
	ダイボンディング材	樹脂ペースト	樹脂ペースト
	ボンディングワイヤー材	Au	Au
	封止材料	エポキシ樹脂 (ハロゲンフリー)	エポキシ樹脂 (ハロゲンフリー)
チップ厚		280μm	254μm
選別テスト拠点		Powertech Technology Inc. (台湾)	←
梱包仕様		現行仕様	←
防湿梱包性能		MSL 3	←
出荷梱包ラベル		現行仕様	フォーマットの変更なし (内部コード、原産国は変更)

(12) 44pin-TSOP(II) 8Mb(3V) x8 製品型名 : RMLV0808BGSB-4S2

項目		現行組立拠点品 (ATM品)	追加組立拠点品 (GTK品)
発注型名		RMLV0808BGSB-4S2#AA0 (トレイ品)	←
		RMLV0808BGSB-4S2#HA0 (Tape & Reel品)	←
組立拠点		Amkor Technology Malaysia Sdn. Bhd. (マレーシア)	Greatek Electronics Inc. (台湾)
マーキング原産国表示		MALAYSIA	TAIWAN
JEITA Package Code		P-TSOP(2)44-10.16x18.41-0.80	←
パッケージ表面仕様		<p>製品型名 電気特性 デートコード インデックスマーク 原産国 (後工程:組立)</p>	<p>製品型名 電気特性 デートコード インデックスマーク 原産国 (後工程:組立)</p>
アセンブリ材料	リードフレーム材質	Cu	Cu
	インナーリード形状	現行形状 (ATM独自仕様)	ATM品とは形状異なる (GTK独自仕様)
	アウターリード形状	現行形状	ATM品と互換性あり
	リードめっき材	純Sn	純Sn
	ダイボンディング材	樹脂ペースト	樹脂ペースト
	ボンディングワイヤー材	Au	Au
	封止材料	エポキシ樹脂 (ハロゲンフリー)	エポキシ樹脂 (ハロゲンフリー)
チップ厚		280μm	254μm
選別テスト拠点		Powertech Technology Inc. (台湾)	←
梱包仕様		現行仕様	←
防湿梱包性能		MSL 3	←
出荷梱包ラベル		現行仕様	フォーマットの変更なし (内部コード、原産国は変更)

(13) 44pin-TSOP(II) 8Mb(3V) x16 製品型名： RMLV0816BGSB-4S2

項目		現行組立拠点品 (ATM品)	追加組立拠点品 (GTK品)
発注型名		RMLV0816BGSB-4S2#AA0 (トレイ品)	←
		RMLV0816BGSB-4S2#HA0 (Tape & Reel品)	←
組立拠点		Amkor Technology Malaysia Sdn. Bhd. (マレーシア)	Greatek Electronics Inc. (台湾)
マーキング原産国表示		MALAYSIA	TAIWAN
JEITA Package Code		P-TSOP(2)44-10.16x18.41-0.80	←
パッケージ表面仕様			
アセンブリ材料	リードフレーム材質	Cu	Cu
	インナーリード形状	現行形状 (ATM独自仕様)	ATM品とは形状異なる (GTK独自仕様)
	アウターリード形状	現行形状	ATM品と互換性あり
	リードめっき材	純Sn	純Sn
	ダイボンディング材	樹脂ペースト	樹脂ペースト
	ボンディングワイヤー材	Au	Au
	封止材料	エポキシ樹脂 (ハロゲンフリー)	エポキシ樹脂 (ハロゲンフリー)
チップ厚		280μm	254μm
選別テスト拠点		Powertech Technology Inc. (台湾)	←
梱包仕様		現行仕様	←
防湿梱包性能		MSL 3	←
出荷梱包ラベル		現行仕様	フォーマットの変更なし (内部コード、原産国は変更)

(14) 48pin-TSOP(I) 8Mb(3V) 製品型名 : RMLV0816BGSA-4S2

項目	現行組立拠点品 (ATM品)	追加組立拠点品 (GTK品)	
発注型名	RMLV0816BGSA-4S2#AA0 (トレイ品)	←	
	RMLV0816BGSA-4S2#KA0 (Tape & Reel品)	←	
組立拠点	Amkor Technology Malaysia Sdn. Bhd. (マレーシア)	Greatek Electronics Inc. (台湾)	
マーキング原産国表示	MALAYSIA	TAIWAN	
JEITA Package Code	P-TSOP(1)48-12x18.4-0.50	←	
パッケージ表面仕様	<p>インデックスマーク</p> <p>RMLV0816BGSA → 製品型名 MALAYSIA -4S2 → 電気特性 XXXXXXXXX → デートコード</p> <p>原産国 (後工程: 組立)</p>	<p>インデックスマーク</p> <p>RMLV0816BGSA → 製品型名 TAIWAN -4S2 → 電気特性 XXXXXXXXX → デートコード</p> <p>原産国 (後工程: 組立)</p>	
アセンブリ材料	リードフレーム材質	Cu	Cu
	インナーリード形状	現行形状 (ATM独自仕様)	ATM品とは形状異なる (GTK独自仕様)
	アウターリード形状	現行形状	ATM品と互換性あり
	リードめっき材	純Sn	純Sn
	ダイボンディング材	樹脂ペースト	樹脂ペースト
	ボンディングワイヤー材	Au	Au
	封止材料	エポキシ樹脂 (ハロゲンフリー)	エポキシ樹脂 (ハロゲンフリー)
チップ厚	280μm	254μm	
選別テスト拠点	Powertech Technology Inc. (台湾)	←	
梱包仕様	現行仕様	←	
防湿梱包性能	MSL 3	←	
出荷梱包ラベル	現行仕様	フォーマットの変更なし (内部コード、原産国は変更)	

(15) 48pin-TSOP(I) 16Mb(3V) 製品型名 : RMLV1616AGSA-5S2

項目	現行組立拠点品 (ATM品)	追加組立拠点品 (GTK品)	
発注型名	RMLV1616AGSA-5S2#AA0 (トレイ品)	←	
	RMLV1616AGSA-5S2#KA0 (Tape & Reel品)	←	
組立拠点	Amkor Technology Malaysia Sdn. Bhd. (マレーシア)	Greatek Electronics Inc. (台湾)	
マーキング原産国表示	MALAYSIA	TAIWAN	
JEITA Package Code	P-TSOP(1)48-12x18.4-0.50	←	
パッケージ表面仕様	<p>インデックスマーク</p> <p>RMLV1616AGSA → 製品型名 MALAYSIA -5S2 → 電気特性 XXXXXXXX → データコード</p> <p>原産国 (後工程: 組立)</p>	<p>インデックスマーク</p> <p>RMLV1616AGSA → 製品型名 TAIWAN -5S2 → 電気特性 XXXXXXXX → データコード</p> <p>原産国 (後工程: 組立)</p>	
アセンブリ材料	リードフレーム材質	Cu	Cu
	インナーリード形状	現行形状 (ATM独自仕様)	ATM品とは形状異なる (GTK独自仕様)
	アウターリード形状	現行形状	ATM品と互換性あり
	リードめっき材	純Sn	純Sn
	ダイボンディング材	樹脂ペースト	樹脂ペースト
	ボンディングワイヤー材	Au	Au
	封止材料	エポキシ樹脂 (ハロゲンフリー)	エポキシ樹脂 (ハロゲンフリー)
チップ厚	280μm	254μm	
選別テスト拠点	Powertech Technology Inc. (台湾)	←	
梱包仕様	現行仕様	←	
防湿梱包性能	MSL 3	←	
出荷梱包ラベル	現行仕様	フォーマットの変更なし (内部コード、原産国は変更)	

(16) 48pin-TSOP(I) 32Mb(3V) 製品型名 : RMLV3216AGSA-5S2

項目	現行組立拠点品 (ATM品)	追加組立拠点品 (GTK品)	
発注型名	RMLV3216AGSA-5S2#AA0 (トレイ品)	←	
	RMLV3216AGSA-5S2#KA0 (Tape & Reel品)	←	
組立拠点	Amkor Technology Malaysia Sdn. Bhd. (マレーシア)	Greatek Electronics Inc. (台湾)	
マーキング原産国表示	MALAYSIA	TAIWAN	
JEITA Package Code	P-TSOP(1)48-12x18.4-0.50	←	
パッケージ表面仕様	<p>インデックスマーク</p> <p>RMLV3216AGSA MALAYSIA -5S2 XXXXXXXX</p> <p>製品型名 電気特性 デートコード</p> <p>原産国 (後工程: 組立)</p>	<p>インデックスマーク</p> <p>RMLV3216AGSA TAIWAN -5S2 XXXXXXXX</p> <p>製品型名 電気特性 デートコード</p> <p>原産国 (後工程: 組立)</p>	
アセンブリ材料	リードフレーム材質	Cu	Cu
	インナーリード形状	現行形状 (ATM独自仕様)	ATM品とは形状異なる (GTK独自仕様)
	アウターリード形状	現行形状	ATM品と互換性あり
	リードめっき材	純Sn	純Sn
	ダイボンディング材	樹脂ペースト	樹脂ペースト
	ボンディングワイヤー材	Au	Au
	封止材料	エポキシ樹脂 (ハロゲンフリー)	エポキシ樹脂 (ハロゲンフリー)
チップ厚	280μm	254μm	
選別テスト拠点	Powertech Technology Inc. (台湾)	←	
梱包仕様	現行仕様	←	
防湿梱包性能	MSL 3	←	
出荷梱包ラベル	現行仕様	フォーマットの変更なし (内部コード、原産国は変更)	

改定記録	別紙 : CST-R2-AJ151 補足資料
------	------------------------

Rev.	発行日	改訂内容
1.0	2022/7/27	初版発行